

研华携手高通 共创边缘智能新未来

德国纽伦堡2024年4月10日 /美通社/ --

全球工业物联网品牌厂商研华科技今日在全球最大嵌入式电子与工业计算机应用展（Embedded World 2024）宣布与高通技术公司（Qualcomm Technologies, Inc.）达成战略合作，携手为边缘计算领域带来变革。未来，双方将高度整合人工智能专业知识、高效能运算与领先业界的通讯技术，为智能物联网应用量身打造专属的解决方案，共创边缘人工智能生态系多元且开放的新格局。



研华嵌入式物联网平台事业群总经理张家豪指出，要在海量资料且碎片化的物联网产业中有效部署人工智能应用是件极具挑战的任务。研华与高通对于追求超越极限的信念一致，双方将携手合作，打造具有高度互操作性的边缘人工智能平台，共同克服物联网产业的碎片化挑战，重新定义边缘人工智能的未来，并为边缘智能应用创造更多可能性。

高通技术公司资深副总裁暨工业和嵌入式物联网总经理Jeff Torrance表示，研华与高通的合作，为边缘计算产业的发展树立了重要里程碑。通过结合研华在工业计算机领域的专业知识与高通的尖端技术，我们将能重塑嵌入式系统的未来。此次合作将为AIoT应用开启全新可能，实现在边缘无缝整合由AI驱动的方案。我们非常兴奋可以参与这个历史性的时刻，并且期待见证边缘智能对各行各业带来的变革。

高通技术公司正在边缘计算领域中引领产业转型，其针对部分物联网系统单芯片推出的长期产品计划（Product Longevity Program），可以推进人工智能技术及业界连接系统的发展，并预期能为工业自动化、交通、医疗以及机器人与能源等领域创造更大的效益。

高通与研华的合作，彰显了双方在专业技术领域持续追求创新的决心。此次合作将促进研华开发出一系列先进的边缘人工智能平台，以及专门用于边缘人工智能应用的软件开发工具包（SDK）。这些兼具标准化和多样化的特性的平台，将在未来推动产业向更依赖智能和效能密集型技术的方向发展。

通过这次合作，研华计划将高通在业界领先的系统单芯片，整合到其边缘智能平台相关的产品线中，包括AI模块、AI主板和AI边缘系统等。两家公司还将共同制定市场进入策略，以加快嵌入式产业的数字化转型，并推动物联网领域中的边缘智能设备持续创新和广泛拓展。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/209167.html>